



第 25 届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国·天津

<http://www.icept.org>

演讲题目: 用于高温电子封装的低温烧结纳米银浆

演讲人: 梅云辉 常务副院长 天津工业大学科学技术研究院院长兼电气工程学院

演讲摘要:

演讲大纲:

适合对象:

演讲人简介:

梅云辉，天津工业大学电气工程学院，教授、博导、科学技术研究院院长，电气工程学院常务副院长。长期从事电力电子器件封装与可靠性研究，近年主持国家“优青”，天津市“杰青”，国家基金项目、国防预研项目、“xx 行动”项目、航空基金、华为、蔚来汽车、汇川技术等企业合作项目近 30 项，参与国家基金重点项目、863 项目等。担任中国电源学会理事、元器件专委会副主任、IEEE Senior Member、《电源学报》编委、天津市电源学会副理事长等。发表学术论文 150 余篇，其中 SCI 论文收录 104 篇，授权发明专利 29 件，曾获 IEEE CPMT Young Award（电子封装学会优秀青年奖）、中国电源学会技术发明奖一等奖（第一完成人）、中国电工技术学会技术发明奖一等奖（第一完成人）、天津市技术发明奖一等奖（第二完成人）、教育部霍英东教育基金高等院校青年科技奖、电工技术—正泰科技奖、IEEE 国际电力电子年会 APEC Best Presentation Award、国家第三代半导体产业技术创新战略联盟(CASA)“特别贡献奖”等。